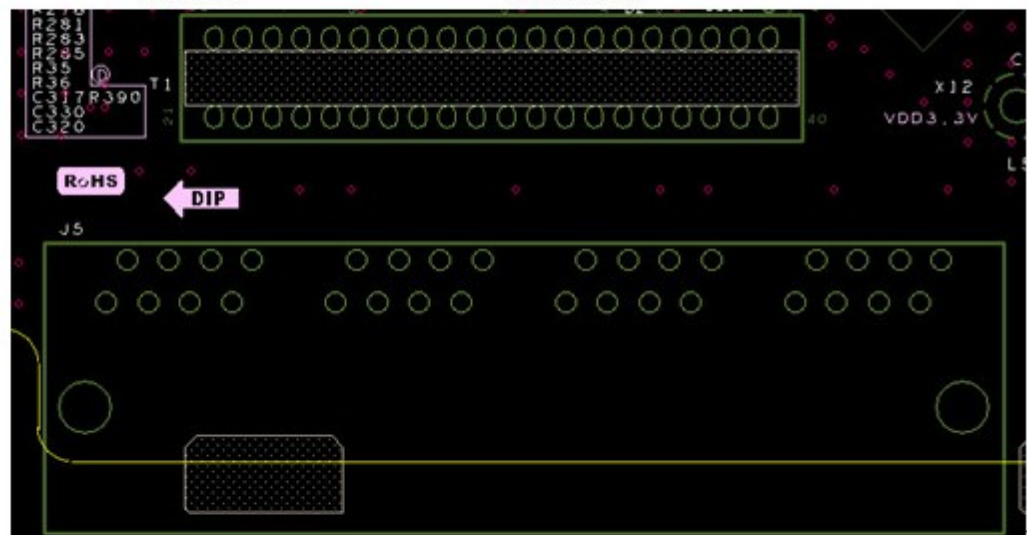


	A1																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2																			

4. 平衡铜点要求：

说明：若提供的原 GERBER 文件中没有加平衡铜点（阻流铜块），须酌情在印制板内外层的空白区域、工艺边上加平衡铜点。平衡铜点要求：边长为 60mil 的正方形，各平衡铜点边缘间距 60mil，与有效性线路的间距大于等于 60mil。

不可增加平衡铜点区域：该区域不能加平衡铜点。



左边说加平衡铜，右边说不加？

15. 其他处理工艺要求：

- 1) 必须通过 100%通断测试，并提供测试报告。
- 2) 内层孤立焊盘（即非功能焊盘）删除。靠近外形的孔照做，允许破板。
- 3) 靠近外形线路极限削铜，不允许板边露铜。
- 4) 若资料中焊环直径小于或等于孔径且无电气连接性能的孔，按非金。
- 5) 若两个金属化孔连在一起，允许将他们改为槽孔。
- 6) 钻孔位置以及 NPTH 在顶层线路钻到铜皮上，必须挖开铜皮，保证其。
- 7) 对于过电孔的焊盘不够大时，如果线路间距小时，允许在颈位处加。
- 8) 对于过电孔的焊盘不够大时，如果线路间距小时，允许在颈位处加。
- 9) 对于过电孔的焊盘不够大时，如果线路间距小时，允许在颈位处加。
- 10) 对于过电孔的焊盘不够大时，如果线路间距小时，允许在颈位处加。
- 11) 板上不要添加平衡铜点。